
目录

第一章 市场预测.....	6.....
一、 半导体分立器件行业发展趋势.....	6.....
二、 半导体分立器件行业发展趋势.....	8.....
三、 半导体分立器件应用领域情况.....	11.....
第二章 公司基本情况	
一、 公司基本信息	19.....
二、 公司简介.....	19.....
三、 公司竞争优势	20.....
四、 公司主要财务数据	22.....
公司合并资产负债表主要数据	22.....
公司合并利润表主要数据	22.....
五、 核心人员介绍	23.....
六、 经营宗旨.....	24.....
七、 公司发展规划	24.....
第三章 项目投资背景分析.....	
一、 半导体分立器件行业特点.....	30.....
二、 行业的竞争格局	32.....
三、 影响行业发展的机遇与挑战.....	34.....
第四章 建筑物技术方案	

一、项目工程设计总体要求	38
二、建设方案.....	40
三、建筑工程建设指标	42
建筑工程投资一览表	42
第五章 SWOT 分析.....	
一、优势分析（S）	44
二、劣势分析（W）	46
三、机会分析（O）	46
四、威胁分析（T）	47
第六章 发展规划.....	
一、公司发展规划	55
二、保障措施.....	59
第七章 法人治理.....	
一、股东权利及义务	62
二、董事.....	64
三、高级管理人员	69
四、监事.....	71
第八章 建设进度分析	
一、项目进度安排	73
项目实施进度计划一览表	73

二、项目实施保障措施	74
第九章 劳动安全生产分析.....	
一、编制依据.....	75
二、防范措施.....	78
三、预期效果评价	82
第十章 组织机构管理	
一、人力资源配置	83
劳动定员一览表.....	83.....
二、员工技能培训	83
第十一章 项目投资分析	
一、编制说明.....	86
二、建设投资.....	86
建筑工程投资一览表	87.....
主要设备购置一览表	88.....
建设投资估算表.....	89.....
三、建设期利息.....	90.....
建设期利息估算表.....	90
固定资产投资估算表	91
四、流动资金.....	92
流动资金估算表.....	93.....

五、项目总投资.....	94.....
总投资及构成一览表	94.....
六、资金筹措与投资计划	95.....
项目投资计划与资金筹措一览表.....	95.....
第十二章 项目招投标方案.....	
一、项目招标依据	97.....
二、项目招标范围	97.....
三、招标要求.....	98.....
四、招标组织方式	98.....
五、招标信息发布	102.....
第十三章 风险风险及应对措施	
一、项目风险分析	103.....
二、项目风险对策	105.....
第十四章 项目总结	
第十五章 附表附录	
建设投资估算表.....	109.....
建设期利息估算表.....	109.....
固定资产投资估算表	110.....
流动资金估算表.....	111.....
总投资及构成一览表	112.....

项目投资计划与资金筹措一览表.....	113.....
营业收入、税金及附加和增值税估算表.....	114.....
综合总成本费用估算表	115.....
固定资产折旧费估算表	116.....
无形资产和其他资产摊销估算表.....	117.....
利润及利润分配表.....	117.....
项目投资现金流量表	118.....

第一章 市场预测

一、半导体分立器件行业发展趋势

信息产业数字化、智能化、网络化的不断推进，新材料（如 GaN、AlN、SiC、SiGe、锑化物、金刚石、有机材料等）和新技术（如微纳米、MEMS、碳纳米管等）的不断涌现，都将对半导体分立器件未来的发展产生深远的影响，将会从不同的侧面促进半导体分立器件向高频、宽带、高速、低噪声、大功率、大电流、高线性、大动态范围、高效率、高亮度、高灵敏度、低功耗、低成本、高可靠、微小型等方面快速发展。此外，随着智能移动终端、5G 网络、物联网、新能源汽车、大数据、人工智能等新兴行业的发展，新型半导体分立器件也将不断涌现。

1、新产品、新材料不断涌现，不断拓展新的应用领域

当前半导体分立器件产业正在发生深刻的变革，其中新材料成为产业新的发展重心。以碳化硅（SiC）、氮化镓（GaN）等材料为代表的新材料半导体因其宽禁带、高饱和漂移速度、高临界击穿电场等优异的性能而受到行业关注，有望成为新型的半导体材料。SiC、GaN 等半导体材料属于新兴领域，具有极强的应用战略性和前瞻性。目前美欧、日韩及台湾等地区已经实现 SiC、GaN 等新材料半导体功率器件的

量产。新材料半导体的涌现将不断提升半导体器件的性能，使得产品能够满足更多应用领域的需求。

对国内市场而言，功率二极管、功率三极管、晶闸管等分立器件产品大部分已实现国产化，而 MOSFET、IGBT 等分立器件产品，尤其是高功率器件，由于其技术及工艺的先进性，还较大程度上依赖进口，未来进口替代空间巨大。目前，国内行业内企业通过多年的技术和资本积累，依托国家产业政策的重点扶持，也已开始布局新型半导体材料领域，并取得了一定成效。

2、小型化、模块化、系统化程度不断提升

未来伴随着移动智能终端、5G 网络、物联网、新能源、AR/VR 等新兴行业的发展，新型半导体分立器件将不断涌现，在替代原有市场应用的同时，将持续开拓新兴应用领域。同时，为了使现有半导体分立器件能适应市场需求的快速变化，需要采用新技术、开发新的应用材料、继续优化完善结构设计、制造工艺和封装技术等，提高器件的性能。此外，下游电子信息产品小型化、智能化发展趋势，必然要求内嵌其中的半导体分立器件等关键零部件尽可能小型化、微型化以及多功能化。为适应整机装配效率和提高整机性能可靠性、稳定性的要求，半导体分立器件将趋于体积小型化、组装模块化、功能系统化。

3、产业链属性决定 IDM 将成为主流发展模式

半导体分立器件产业链主要包含器件及芯片设计、芯片制造、封装测试三大工艺环节，根据所涉及经营环节的不同，半导体分立器件制造业的经营模式分为纵向一体化（IDM）以及垂直分工两种。

由于分立器件在投资规模方面采用 IDM 模式具备经济效益上的较强可行性，同时半导体分立器件的产品设计和生产工艺都对产品性能产生较大影响，对企业设计与工艺结合能力要求较高，业内领先企业一般沿着原有业务进行产业链延伸，逐步完善 IDM 模式发展。

由于不同企业的发展历程及技术优势不同，分立器件行业发展 IDM 模式有两种典型路径：一类是以芯片技术为基础的公司，该类企业通常在特定品种的分立器件拥有较强的竞争优势，为客户提供自主芯片对应的分立器件，在发展过程中逐步补强封测技术和产能。另一类是以封测技术为基础的公司，该类企业具备“多品种、多规格”的产品系列，可以为客户提供“一站式”采购服务，在发展过程中不断发展芯片技术和产能。

二、半导体分立器件行业发展趋势

信息产业数字化、智能化、网络化的不断推进，新材料（如 GaN、AlN、SiC、SiGe、锑化物、金刚石、有机材料等）和新技术（如微纳米、MEMS、碳纳米管等）的不断涌现，都将对半导体分立器件未来的发展产生深远的影响，将会从不同的侧面促进半导体分立器件向高频、

宽带、高速、低噪声、大功率、大电流、高线性、大动态范围、高效率、高亮度、高灵敏度、低功耗、低成本、高可靠、微小型等方面快速发展。此外，随着智能移动终端、5G 网络、物联网、新能源汽车、大数据、人工智能等新兴行业的发展，新型半导体分立器件也将不断涌现。

1、新产品、新材料不断涌现，不断拓展新的应用领域

当前半导体分立器件产业正在发生深刻的变革，其中新材料成为产业新的发展重心。以碳化硅（SiC）、氮化镓（GaN）等材料为代表的新材料半导体因其宽禁带、高饱和漂移速度、高临界击穿电场等优异的性能而受到行业关注，有望成为新型的半导体材料。SiC、GaN 等半导体材料属于新兴领域，具有极强的应用战略性和前瞻性。目前美欧、日韩及台湾等地区已经实现 SiC、GaN 等新材料半导体功率器件的量产。新材料半导体的涌现将不断提升半导体器件的性能，使得产品能够满足更多应用领域的需求。

对国内市场而言，功率二极管、功率三极管、晶闸管等分立器件产品大部分已实现国产化，而 MOSFET、IGBT 等分立器件产品，尤其是高功率器件，由于其技术及工艺的先进性，还较大程度上依赖进口，未来进口替代空间巨大。目前，国内行业内企业通过多年的技术和资

本积累，依托国家产业政策的重点扶持，也已开始布局新型半导体材料领域，并取得了一定成效。

2、小型化、模块化、系统化程度不断提升

未来伴随着移动智能终端、5G 网络、物联网、新能源、AR/VR 等新兴行业的发展，新型半导体分立器件将不断涌现，在替代原有市场应用的同时，将持续开拓新兴应用领域。同时，为了使现有半导体分立器件能适应市场需求的快速变化，需要采用新技术、开发新的应用材料、继续优化完善结构设计、制造工艺和封装技术等，提高器件的性能。此外，下游电子信息产品小型化、智能化发展趋势，必然要求内嵌其中的半导体分立器件等关键零部件尽可能小型化、微型化以及多功能化。为适应整机装配效率和提高整机性能可靠性、稳定性的要求，半导体分立器件将趋于体积小型化、组装模块化、功能系统化。

3、产业链属性决定 IDM 将成为主流发展模式

半导体分立器件产业链主要包含器件及芯片设计、芯片制造、封装测试三大工艺环节，根据所涉及经营环节的不同，半导体分立器件制造业的经营模式分为纵向一体化（IDM）以及垂直分工两种。

由于分立器件在投资规模方面采用 IDM 模式具备经济效益上的较强可行性，同时半导体分立器件的产品设计和生产工艺都对产品性能

产生较大影响，对企业设计与工艺结合能力要求较高，业内领先企业一般沿着原有业务进行产业链延伸，逐步完善 IDM 模式发展。

由于不同企业的发展历程及技术优势不同，分立器件行业发展 IDM 模式有两种典型路径：一类是以芯片技术为基础的公司，该类企业通常在特定品种的分立器件拥有较强的竞争优势，为客户提供自主芯片对应的分立器件，在发展过程中逐步补强封测技术和产能。另一类是以封测技术为基础的公司，该类企业具备“多品种、多规格”的产品系列，可以为客户提供“一站式”采购服务，在发展过程中不断发展芯片技术和产能。

三、半导体分立器件应用领域情况

1、家用电器领域

半导体分立器件可以对驱动家用电器的电能进行控制和转换，是家用电器的关键零部件，直接影响到家用电器的性能和品质。在我国家用电器整体升级、市场扩展的大背景下，半导体分立器件将随着家电行业的发展而具有稳定的市场发展前景。我国是全球最大的家电生产国和出口国，近年来在宏观经济环境及住宅产业低迷、产业相对趋于成熟等综合因素的影响下，我国家电行业主要产品产销量增速放缓，部分产品略有下滑，但行业总体依旧处于增长态势。在主要家电产品中，根据国家统计局公布的数据，2019 年，我国电冰箱、彩电、空调、

洗衣机的产量合计达 56,202.6 万台。目前，中国家电消费升级态势保持良好，各家电企业把技术创新作为突破口，重视研发投入，产品结构持续优化，产业转型升级健康发展。中国家电业已经进入以更新消费为主的阶段。未来，各类科技的进一步发展、传统家电的智能化升级以及“一带一路”国际化战略带来的出口机遇将为我国家电行业发展注入持续动力，进而推动其上游半导体分立器件行业的发展。

2、电源及充电器领域

电源市场是半导体分立器件重要的应用领域，电源作为电子设备不可或缺的动力来源，广泛应用于各行各业。根据中国电源学会数据，近年来我国电源产品市场保持增长态势，到 2019 年电源产品产值预计将达到 2,469.9 亿元，近四年的复合增长率保持在 6%以上。

(1) 充电器领域

充电器是智能电子产品的重要配件之一，通过交流直流转换给智能电子产品充电，从而促使其便携易用。近年来，智能电子设备发展快速，尤其是在智能手机领域。根据国家统计局数据，2018 年我国手机年产量已经达 17.98 亿部，虽较 2017 年略微下滑，但整体市场容量仍然巨大。其中我国手机品牌华为、OPPO、VIVO、小米已经稳居全球前十大手机品牌。由于每个智能手机至少都会标配一个充电器，另外为满足不同充电场景的需要，部分手机用户可能会多配置一到两个手

机充电器。由此可见，庞大的智能手机市场对充电器类核心配件形成规模巨大的市场需求。未来随着全球智能手机渗透率在新兴市场的不断提高，以及智能手机更新换代速度的不断加快，全球智能手机市场前景广阔。智能手机市场快速发展必将带动对充电器产品的需求，而半导体分立器件作为充电器产品主要元器件，未来仍有较大的市场发展空间。

（2）电脑电源适配器

近年来，电脑产品在全球的出货量保持相对稳定，但总体容量巨大，作为电脑标配产品的电源适配器也保持相对稳定。而半导体分立器件在电源适配器中有着广泛的应用，主要起到整流、稳压等作用，从而依托于电脑市场的发展而保持长期稳定发展。

（3）工业类电源

工业电源广泛应用于机械、电力、铁路、航空、石化和医疗等行业。近年来，为满足工业产品不断向个性化、多样化、复杂化发展，信息化和智能化制造成为工业领域的发展热点。为满足工业产品的发展要求，工业制造不断融合物联网、大数据、自动化、机电一体化以及嵌入式软件等新技术。新技术的引入需要将更多的机电控制设备应用于工业制造领域中，从而也需要相应的电源转化，而半导体分立器件是实现电源转化的核心元器件，促进了分立器件行业的发展。

3、绿色照明领域

(1) 全球绿色照明现状及前景

在照明领域，半导体照明（简称 LED）作为一种新型的绿色光源产品，具有节能、环保、寿命长、体积小等特点，并广泛应用于各种指示、显示、装饰、背光源、普通照明和城市夜景等领域。目前，LED 已经成为性价比较高的生态光源，全面进入照明替代市场，在全球淘汰白炽灯和限制荧光灯（含汞）使用的大趋势下，全球半导体照明市场呈现爆发式增长。近年来 LED 产品的市场渗透率快速增长，特别是在新增市场的渗透率有较快提升。2015 年全球 LED 灯安装数量在整体照明产品在用量中的渗透率仅为 6%，而预计到 2022 年将接近 40%。随着 LED 市场应用渗透率的不断提高，将推动半导体照明市场的快速发展。

(2) 我国绿色照明现状及发展前景

我国是照明产业大国，近年来 LED 照明增长迅速。根据前瞻产业研究院统计数据显示，2010 年中国 LED 照明产业规模已达 1,200 亿元，到了 2015、2016 年中国 LED 照明产业规模分别突破 4,000、5,000 亿元。在政策的持续利好下，我国 LED 照明行业在经历了 2015 年的发展低谷与 2016 年的缓慢回升后，重新回归发展快车道。截止至 2017 年中国 LED 照明产业规模持续扩大，增长至 6,538 亿元，同比增长 25.35%，增速较前两年显著回升。初步测算 2018 年我国 LED 照明产业

规模达到 7,846 亿元左右，同比增长 20%。未来，国家政策鼓励、LED 渗透率提升以及应用领域扩展，将推动我国半导体照明发展，进而推动对半导体分立器件产品需求的不断增长。此外，半导体照明在农业、医疗、通讯、安全等领域的应用市场也在不断拓展。下游应用领域的不断拓宽，将带动半导体分立器件产品的发展。

4、网络与通信领域

半导体分立器件在网络通信市场的应用主要为家庭端的路由器、调制解调器和机顶盒等产品，以及运营商端的通讯基站、金融机构端的 POS 机、ETC 等设备。2019 年，工信部正式发放 5G 商用牌照，标志着中国正式进入 5G 商用元年，运营商开始在一二线城市大规模部署 5G 基站，并带来了以智能手机为主的移动终端产品的更新。同时，由中国广电负责全国范围内有线电视网络有关业务，开展三网融合，创造了新一轮机顶盒置换需求。同年，WIFI6 无线局域网标准发布，带来路由器的更新需求。另外，随着移动支付的普及，其覆盖范围扩大到生活的每一个环节，POS 机以及 ETC 硬件设备市场快速扩容。上述终端需求的升级给半导体分立器件在网络通信领域的应用带来了快速增长的机会。

5、汽车电子领域

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/818110047142007002>